GLASS WOVEN FABRIC BASE FOR PRINTED CIRCUIT BOARD AND LAMINATE PLATE FOR PRINTED CIRCUIT BOARD

Publication number: JP11241251 **Publication date:**

1999-09-07

Inventor:

MIYASATO KEITA; SATO EIJI

Applicant:

NITTO BOSEKI CO LTD

Classification: - international:

C08J5/24; B32B15/08; B32B17/04; D03D1/00;

D03D15/00; D03D15/12; D03D25/00; H05K1/03; C08J5/24; B32B15/08; B32B17/04; D03D1/00;

D03D15/00; D03D15/12; D03D25/00; H05K1/03; (IPC1-7): D03D1/00; B32B15/08; B32B17/04; C08J5/24;

D03D15/00; D03D15/12; D03D25/00

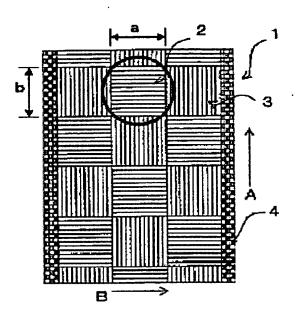
Application number: JP19980042947 19980210

Priority number(s): JP19980042947 19980210; JP19970364352 19971219

Report a data error here

Abstract of **JP11241251**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide glass woven fabric base for a printed circuit board excellent in dimensional stability and surface flatness and a laminated plate to reinforce this glass woven fabric base. SOLUTION: This base has parts in which 10 mm or more of wefts and 10 mm or more of warps do not vertically intersect and, in this part where the wefts and the warps do not intersect, the wefts layer and the warp layer are set to be in a laminated state. The glass woven fabric, excluding the selvedge, preferably has parts comprising a fabric with a plain weave of 2 mm or more of width. A laminated plate for printed circuit board is obtained by using this glass woven fabric base as the reinforcing material.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-241251

(43)公開日 平成11年(1999)9月7日

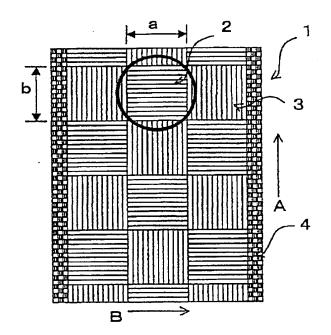
(51) Int. Cl. *	識別記号		FI				
DO3D 1/00			DO3D 1/00)		A	
B32B 15/08			B32B 15/08	3		J	
17/04		17/04		Α			
CO8J 5/24			CO8J 5/24	1			
DO3D 15/00			DO3D 15/00)		Z	
		審査請求	未請求 請求	で項の数7	FD	(全8頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平10-42947		(71)出願人		_		
(22) 出顧日	平成10年(1998) 2月10日			日東紡績		社 野目字東1都	Z-11 h
22) 四殿 口	平成10年(1996) 2 月 10日		(72)発明者			到日子来工程	
31)優先権主張番号	特願平9-364352		(12/30/12			莱町8-4-	-19
32)優先日	平 9 (1997) 12月 19日		(72)発明者	佐藤 栄	<u>+</u>		
33)優先権主張国	日本(JP)			福島県福	島市永	井川字北谷均	性48-5 メゾ
•	•			ンK-I	1 10	1 巳	

(54) 【発明の名称】プリント配線基板用ガラス織布基材及びプリント配線基板用積層板

(57)【要約】

【課題】 寸法安定性や表面平滑性に優れたプリント配線基板を与えるためのガラス織布基材およびこのガラス織布基材を強化材とする積層板の提供を目的とする。

【解決手段】 経糸方向に10mm以上、緯糸方向に10mm以上経糸と緯糸が上下に交差せず、前記経糸と緯糸の非交差部において経糸層と緯糸層が積層状態にあるプリント配線基板用ガラス織布基材、及び耳部を除いた地の部分に間隔を置いて幅2mm以上の平織りなどの部分を有するガラス織布、及びこのガラス織布基材を強化材とするプリント配線基板用積層板。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 経糸方向に少なくとも10mm以上、緯 糸方向に少なくとも10mm以上経糸と緯糸が上下に交 差せず、かつ、前記経糸と緯糸の非交差部において、経 糸層と緯糸層が積層状態にあることを特徴とするプリン ト配線基板用ガラス織布基材。

【請求項2】 請求項1記載のガラス織布基材におい て、両耳部が平織り組織、綾織り組織、朱子織り組織か ら選ばれた織り組織であることを特徴とするプリント配 線基板用ガラス織布基材。

【請求項3】 両耳部を除く織布面に間隔を置いて、経 糸方向に少なくとも2mm以上、緯糸方向に少なくとも 2mm以上の幅をもった、平織り組織、綾織り組織、朱 子織り組織から選ばれた織り組織部分を有する請求項 1、あるいは請求項2記載のプリント配線基板用ガラス 織布基材。

【請求項4】 両耳部を除く織布面の経糸方向あるいは 緯糸方向に間隔を置いて2mm以上の幅をもった、平織 り組織、綾織り紹織、朱子織り組織から選ばれた織り組 織部分を有する請求項1、あるいは請求項2記載のプリ ント配線基板用ガラス織布基材。

【請求項5】 請求項1~請求項4のいずれかのガラス 織布基材において経糸と緯糸の25mm当たりのガラス 糸量の比率(経糸本数×デニール/緯糸本数×デニー ル) 0. 7~1. 4であることを特徴とするプリント配 線基板用ガラス織布基材。

【請求項6】 請求項1~請求項5のガラス織布基材に 合成樹脂を含浸塗布させたことを特徴とするプリント配 線基板用プリプレグ。

【請求項7】請求項1~請求項5のガラス織布基材を強 30 化材とすることを特徴とするプリント配線基板用積層 板。

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は、電子機器、コンピュータ、通信 機器等に用いられるプリント配線板およびその強化材で あるガラス織布基材に関するものである。

[0002]

【従来の技術】 ガラス繊維は、その優れた耐熱性、寸 法安定性、電気特性等の理由からエレクトロニクス分野 で広く使われており、特に、ガラス原糸を製織している 40 ガラス織布は、その優れた特性からプリント配線基板用 素材としての需要が多い。近年、プリント配線板に、I C等を自動挿入する実装方式が増えている。この自動挿 入は、ソルダーレジストの乾燥、ヒュージング等の加熱 などを伴い、プリント配線板は過酷な条件にさらされて いる。この為、プリント配線板に対し、熱による寸法変 化を生じさせることが問題となっている。特に、たて、 よこについて寸法変化が異なる場合、プリント配線基板 の加工工程においてたて、よこに異方性が生じてしま う。従って、プリント配線基板の寸法安定性が、現在の 50 ガラス織布基材を強化材とするプリント配線基板用積層

レベルでは不満足となり、寸法変化に対し異方性のない プリント配線基板が必要になってきた。また、織物の場 合、基板の表面に織物の織り目が微細な凸凹となって現 れる。最近のように配線板が細線化され配線密度が高密 度化すると、この凸凹もできるだけ少ない基板が要求さ れるようになってきている。

【0003】このような問題を解決するために、ガラス 繊維による一方向引揃え基材(以下UD材と称する)を 強化材とするプリント配線基板が提案されている。例え ば、特開平1-216829号、特開平1-21683 0号、特開平4-270657号、特公平7-9060 6号、特開平8-39686号、特開平8-52183 号などにUD材を用いたプリント配線基板の製造法や製 造装置が開示されている。しかし、UD材を強化材とし て用いるプリント配線基板の製造は、従来の製織工程、 ワニス含浸工程、プレス工程を踏まずに生産できること が特徴であるが独自の製造装量を造らねばならず、新た な設備投資を必要とする。また、技術的にも未解決の問 題があり、まだ試作段階の状況にある。また、近年、基 板にスルーホール用の穴を開ける際にレーザーによる穴 明け技術の進歩が目覚ましいが、ガラス織布を強化材と する基板にレーザー加工を施した場合、ガラス織布には 繊維の交差した部分と樹脂だけの部分が存在するため、 穴径を均一に明けられないという可能性がある。

[0004]

【開発が解決しようとする課題】本発明は、現在一般に 用いられているプリント配線基板の製造法を用いること ができ、寸法安定性や表面平滑性に優れたプリント配線 板およびその強化材である一方向性基材の特性を有する ガラス織布基材の提供を目的とする。また、レーザーに よる穴明け加工を行った場合、均一な穴明け加工が可能 なプリント配線基板の提供を目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するために成されたものであり、本発明のガラス織布 基材は、経糸方向に少なくとも10mm以上、緯糸方向 に少なくとも10mm以上経糸と緯糸が上下に交差せ ず、かつ、前記経糸と緯糸の非交差部において、経糸層 と緯糸層が積層状態にあることを特徴とするプリント配 線基板用ガラス織布基材である。また、本発明のガラス 織布基材は、両耳部及び全面において間隔を置いて平織 り組織、綾織り組織、朱子織り組織から選ばれた織り組 織を有することを特徴とするプリント配線基板用ガラス 織布基材である。さらに、本発明のガラス織布基材は、 経糸と緯糸の25mm当たりのガラス糸量の比率(経糸 本数×デニール/緯糸本数×デニール)が0.7~1. 4の範囲にあることを特徴とするプリント配線基板用ガ ラス織布基材である。また、本発明には前記したガラス 織布基材に合成樹脂を含浸塗布させたプリプレグおよび 板も含まれる。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1のガラス織布基 材は,経糸方向に少なくとも10mm以上、緯糸方向に 少なくとも10mm以上にわたって経糸と緯糸が上下に 交差しないことを特徴としている。図1に本発明のガラ ス織布基材の1例を示す。図1に於いて1は本発明のガ ラス織布基材を示し、2が緯糸を3が経糸を示す。図1 においてa、bの長さが10mm以上であるのが請求項 1のガラス織布基材である。通常平織りの場合は、図4 に示すように経糸7、緯糸6が1本おきに上下に交差し て織り組織を形成しているが、本発明の場合は少なくと も10mm以上の間隔をおいて経糸、緯糸が上下に交差 している。 基板用の強化材に用いられるガラス織布の2 5mm当たりの打ち込み本数は30~60本程度である から、これを本発明のガラス織布に適用すると、約8~ 15本単位以上で上下に交差することになる。図1にお いて円に囲まれた4角形の部分では、図示されている緯 糸の部分の裏側に経糸が重なった状態であり、少なくと もこの部分については、一方向に引揃えられた緯糸と、 その緯糸に対して直行し一方向に引揃えられた経糸が重 なっている状態とも見ることができる。従って、この部 分に限っていえば配線基板用の強化材として最も望まし い状態にあるといえる。

【0007】10mm以上に限定した理由は、CSPや BGA、PGAにみられる半導体パッケージ用チップや I Cカード等に搭載される基板用のチップが10mm以 上であるためである。チップをこの部分に合わせて実装 するとUD材による基板に近い効果を得ることができ る。本発明のガラス織布基材の織り組織を形成する上限 30 は、図2に示すように織物の幅から耳の部分を除いた幅 を単位とすることも可能であるが、プレス機におけるプ レス有効面積も考慮にいれる必要があり、実際上は60 0~650程度が上限で、好ましくは10~400mm 程度の範囲が望ましい。最近のブリント配線板は、小形 化しており25mm角から50mm角程度の大きさのも のが増えている。また、織り組織の単位としては正方形 である必要はなく、長方形であっても良い。即ち、図1 においてa、bの値が異なっても良い。図2は、本発明 のガラス織布基材の他の例を示し、基材11は緯糸22 と経糸33から構成されており、両側に耳部44を有し ている。耳部44では、経糸と緯糸が1本おきに交差し て平織りを形成しているが地の部分では地の部分の幅単 位で経糸と緯糸が上下に交差している。Aはたて方向、 Bはよこ方向を示す。

【0008】本発明の請求項2のガラス織布基材は、請求項1のガラス織布基材において両耳部に平織り、綾織り、集子織りなどの織り組織を有するものである。請求項1のガラス織布基材は、織り組織としてはルーズな織であるため、取扱い性が必ずしも良くない。この 50 ラス、Sガラス、Dガラス、Qガラス等のSiO。を主

取扱い性を改良するために図1や図2に示すように両端 部に耳組織部4や44が設けられている。耳組織として は、平織り、綾織り、朱子織りなどが可能であるが組織 が一番しっかりしている点では平織りが望ましい。平織 りの中には平織りの変わり織り組織とされる斜子織り等 も含まれる。耳組織部の幅は少なくとも2mm以上は必 要である。本発明の請求項3、請求項4のガラス織布基 材は、請求項1、請求項2のガラス織布基材の両耳部を 除く全面において、間隔を置いて平織り、綾織り、朱子 織りなどの織り組織を有するものである。請求項1、請 求項2のガラス織布基材の両耳部を除く全面において は、織り組織としてはルーズな織り組織であるため、堅 型乾燥炉を伴ったワニス含浸工程によりプリプレグを作 成した場合、織物の製織幅が広いものになるに従い、含 浸した樹脂の重みで塗工進行方向と反対方向に緯糸のた るみが発生し易く、作成されたプリプレグの外観が必ず しも良くない。このプリプレグ作成時におけるたるみの 発生を改良するために図3に示すような一定の間隔ある いは間欠的に幅の極狭い目止め用の織り組織が設けられ ている。 図3は、本発明のガラス織布基材の緯糸たる みの改良例を示し、基材111は緯糸222と経糸33 3から構成されており、織布全体において、間欠的に目 止め用の織り組織部444を有している。目止め用の織 り組織部444の織り組織としては、平織り、綾織り、 朱子織りなどが可能であるが組織が一番しっかりしてい る点では平織りが望ましい。平織りの中には平織りの変 わり組織とされる斜子織り等も含まれる。目止め用の織 り組織部の幅については、用途によっては経糸が1-数 本でも良いが、通常2mm以上であれば良く、好ましく は4mm~6mmの範囲である。本発明の請求項5のガ ラス織布基材は,経糸と緯糸の25mm当たりのガラス 糸量の比率(経糸本数×デニール/緯糸本数×デニー ル) が0. 7~1. 4の範囲にあることを特徴とするも のである。プリント配線基板用ガラス織布基材として一 般に使用されている7628タイプの場合、25mm当 たりの経糸、緯糸の打ち込み本数は44本と32本であ り、経/緯比が1.4である。従って、7628タイプ の織布を織っている織機を緯糸打込み用ギアと経糸ビー ムをそのまま転用でき、本発明のガラス織布基材を安価 に製造することができる。

【0009】しかし、本発明の効果である寸法安定性の良い基板を得るためには、経/総比が0.8~1.2の範囲であることが望ましく、更に、経方向、緯方向の寸法変化率の差を小さくするためには、0.9~1.1の範囲にするのが好ましい。また、経糸と緯糸の番手を変えて打込む場合も、打込み糸量の経/緯比を同様に0.9~1.1の範囲にすることが好ましい。本発明のガラス織布基材に用いられるガラス繊維としては、プリント配線用基板の強化材として従来より使用されているEガラス、Sガラス、Dガラス、Oガラス等のSiO・を主

ント径としては3~13μmの範囲のガラス繊維を用い ることができる。 3μmより小さい場合は、製織性など の作業性が悪く、13μmより大きい場合は、基板にし た場合のドリル加工性が低下する。一般的には、5~9 μmの範囲が望ましい。番手としては20~25,00 0 デニールのガラス繊維を使用できる。より太い糸を用 いた場合は、製織効率が上がるので経済的にはメリット があるが、その反面、耳止めするための端部が粗い組織 となるため、広い幅の耳組織が必要となる。従って、2 10 mm程度で耳止めのできる範囲の糸の太さが望ましい。 耳止めの効果を得るためには幅方向に少なくとも3回以 上緯糸が織り込まれていることが必要である。糸のより 数としては特に制限はないがより数の小さい方が望ま く、無撚糸でも良い。また合撚糸でも使用可能である。 【0010】本発明に用いられるガラス繊維は、澱粉系 の集束剤を使用することができる。この場合、ガラス織 布基材は、定法により加熱脱油され、その後シランカッ プリング剤により表面処理が行われる。シランカップリ ング剤としては、従来公知のものが適宜使用できる。従 20 来公知のシランカップリング剤として代表的なものは、 例えば、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリメトキシ シラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、ヮーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、 y-アミノプロピルトリエトキシシラン、y-(2-ア ミノエチル) アミノプロピルトリメトキシシラン、Nβ- (N-ビニルベンジルアミノエチル) -γ-アミノ プロピルトリメトキシシラン・塩酸塩、N-フェニルー yーアミノプロピルトリメトキシシラン、yークロロブ ロピルトリメトキシシラン、γーメルカプトブロピルト 30 リメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、βー (3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキ シシラン等を挙げることができる。 シランカップリン グ剤は通常水溶液、またはアルコール類、ケトン類、グ リコール類、エーテル類、ジメチルホルムアミド等の有 機溶媒の溶液、あるいは水とこれら有機溶媒との混合溶 媒の溶液として0.01~5重量%の濃度で使用され る。ガラス繊維の表面に付着させるシランカップリング 剤の量(固形分基準)としては、0.001~0.5重 量%の範囲が好ましく、更に好ましくは0.01~0. 2重量%の範囲である。

【0011】本発明に使用されるガラス繊維として、澱粉系の集束剤を使わずに合成樹脂系の集束剤を用いることもできる。例えばアミン付加やエチレンオキサイド付加によりエポキシ樹脂を変性したもの、ウレタン樹脂を変性したものなどを主成分とし、シランカップリング剤も集束剤中に配合する。この場合は、集束剤を除去する必要がなく、製織されたガラス織布基材は、そのままプリプレグ工程に投入することができる。本発明のガラス織布基材は、厚さは0.03~0.4mmの範囲であれ50

ば良く質量としては30~400g/m²の範囲であれ ば良い。本発明のガラス織布基材を製織する織機として は、一般に、ガラス織布の製織に使用されている織機で あれば特に制限がなく、エアジェット織機やシャットル 織機、レピア織機等が使用できる。耳組織を別に設ける 場合は、耳の部分と地の部分の組織の違いによる経糸の テンションむらを吸収するために、テンションコントロ ーラーを設置したり、耳の部分用のビームと地の部分用 のビームを別に設置しそれぞれのテンションを制御する 方法などの手段を講じる必要がある。また緯糸のたるみ を防ぐために両耳部分を除く織布全面に目止め用の織り 組織を別に設ける場合についても、耳組織を別に設ける 場合と同様に前記方法による手段を講じる必要がある。 本発明の請求項6のプリプレグは、本発明のガラス織布 基材にエポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの合成樹脂を 含浸させて作成される。合成樹脂としては、熱硬化性樹 脂や熱可塑性樹脂を使用できるが、含浸性の点を考慮す ると熱硬化性樹脂が望ましい。本発明に用いられる熱硬 化性樹脂としては、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポ リエステル樹脂、フェノール樹脂等の単独、または混合 樹脂が用いられる。これらの熱硬化性樹脂は、溶媒タイ ブでも無溶媒タイプでもよい。また、本発明に用いられ るエポキシ樹脂としては、従来公知のものが適宜使用で きる。例えばビスフェノールAのジグリシジルエーテ ル、ビスフェノールFのジグリシジルエーテル、臭素化 エポキシ樹脂、ノボラック樹脂のポリグリシジルエーテ ル等が挙げられる。

【0012】これらエポキシ樹脂には、通常、硬化剤 (促進剤)が併用され、これらの硬化剤(促進剤)とし ては、アミン系、酸無水物系、エポキシ系等の硬化剤 (促進剤)を挙げることができる。アミン系の硬化剤と しては、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミ ン、ジエチルアミノプロピルアミノ、テトラエチレンペ ンタミン、脂肪族ポリエーテルトリアミン、ジシアンジ アミド、4, 4´ーメチレンジアニリン(MDA)、m ーフェニレンジアミン (MPDA) 、4,4´ージアミ ノジフエニルスルフオン、2、6-ジアミノピリジン (DAP) 、33. 3%MPDA-33. 3%MDA-33. 3%イソプロピルMDPA、40%MDA-60 %ジエチルMDA、40%MPDA-60%MDA、ア ミノポリアミド、2一エチルー4ーメチルイミダゾー ル、2,4,6ートリス(ジメチルアミノエチル)フエ ノール等が挙げられる。また、酸無水物系の硬化剤とし ては、フタル酸無水物、ヘキサヒドロフタル酸無水物、 ナディクメチルアンハイドライド、ドデシルコハク酸無 水物、クロレンディクアンハイドライド、トリメリト酸 無水物、マレイン酸無水物、コハク酸無水物、メチルテ トラヒドロフタル酸無水物、3,3~,4,4~ーベン ソフェノンーテトラカルボン酸二無水物等が挙げられ

【0013】さらにエポキシ系の硬化剤としては、ブチ ルグリシジルエーテル、ヘプチルグリシジルエーテル、 オクチルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテ ル、p-t-ブチルフエニルグリシジルエーテル、フエ ニルグリシジルエーテル、クレジルグリシジルエーテル 等が挙げられる。本発明に用いられるポリイミド樹脂と しては、従来公知のものが適宜使用できる。代表的なも のとしては、ケルイミド [ローヌプーラン(株)製]、 キネル [デュポン (株) 製]、カプトン [デュポン

(株) 製]、BTレジン [三菱ガス化学(株) 製] 等が 10 挙げられる。本発明に用いられるフェノール樹脂として は、従来公知のものが適宜使用できる。代表的なものと しては、ノボラック型フエノール樹脂、レゾール型フェ ノール樹脂、炭化水素変性フェノール樹脂、シリコーン 樹脂変性フェノール樹脂、エポキシ樹脂変性フェノール 樹脂等が挙げられる。ガラス織布基材に樹脂を含浸させ る方法は、常法により行い樹脂分は20~70%の範囲 が望ましい。本発明の請求項7の積層板は本発明のガラ ス織布基材を強化材とするものであり、表面の少なくと も一方に、銅、金、銀等からなる導電性金属箔層を有し 20 ていてもよい。このような導電性金属箔層は、プレス法 等の常法により形成することができる。又、本発明の積 層板は、内層配線を備えたものであってもよい。これら 導電性金属箔層を有する積層板は、プリント配線基板等 の材料として好適である。

【0014】本発明の積層板は、一方向性のガラス織布 基材を用いているため、経糸と緯糸が上下に交差しない 部分についていえば、UDシートを強化材として用いた のと同様な効果を有する。従って、通常の平織り組織の ように糸が一本おきに上下することによる糸に対する拘 30 束効果が少ないため、樹脂の含浸性が改善され、その結 果、耐熱性や寸法安定性の良い積層板が得られる。ま た、UDシートの場合と同様に、表面平滑性の良い積層 板が得られる。寸法安定性については、一方向材による 効果と含浸性が改善されることによる効果とが重なっ て、寸法安定性の良好な積層板が得られる。さらには、 本発明のガラス織布基材は、経糸と緯糸が上下に交差す る回数が少ないため打込み本数を通常の平織り組織の場 合より上げることが可能であり、組織の密な織布基材を 得ることができる。図4に通常の平織り組織のガラス織 40 布を示してあるが、8は経糸と緯糸が重なっている部分

[エポキシ樹脂ワニスの組成]

・エピコート1001 [油化シェルエポキシ(株)製]

・エピコート154 [油化シェルエポキシ(株)製] 20部

・ジシアンジアミド

4部

80部

・ベンジルジメチルアミン

0. 2部

・ジメチルフオルムアミド

30部

積層板の製造

上記プリプレグを2枚積層し、さらにその上下に厚さ1 $8~\mu$ mの銅箔を重ね、定法により加熱成形し厚さ 0. 2 50 つ、上下のプリプレグの非交差部分が丁度重なるように

であり、9は経糸と緯糸に囲まれた空隙部分である。本 発明のガラス織布基材では、この空隙部を小さくするこ とができるため、積層板にレーザー光で穴明けする際に レーザー光のエネルギー損失を少なくすることができ る。

[0015]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。な お以下の文中%及び部は、特記、しない限り重量%及び 重量部をそれぞれ意味する。

<実施例1>

(1) ガラス織布基材の製造

1、ガラス織布基材の製織

ガラス織布基材として、

ガラス糸 経糸 ECE225 1/0 緯糸 ECE225 1/0 ガラス糸

59本/25mm 経糸打込み本数 59本/25mm 緯糸打込み本数 質量 105g/m2 0.10mm 匣み

経糸と緯糸の非交差部分の長さ

3 5 0 mm たて方向 350mm よこ方向

耳部分の織り組織は平織りで耳幅は5mm の条件で製織しガラス織布基材を得た。

【0016】2、 ガラス織布基材の表面処理 シランカップリング剤としてN-β-(N-ビニルベン ジルアミノエチル) - y - アミノプロピルトリメトキシ シラン・塩酸塩 [東レ・ダウコーニング・シリコーン (株) 製; S Z -6032] を用い、このシランカップリン グ剤を0.5%(固形分)、酢酸を3.0%含有する水 溶液を得た後、この水溶液に若干のメタノールを加えシ ランカップリング剤を含有する処理液を調整した。次 に、1、で得られたガラス織布基材を加熱脱油した後、 上記処理液に浸潰し、マングルを用いてピックアップ3 0%となるように絞液した後、110℃で加熱乾燥し て、シランカップリング剤を表面に付着させたガラス織 布を得た。

【0017】3、 プリプレグの製造

上記ガラス織布基材を、下記組成のエポキシ樹脂ワニス (G-10処方) に浸漬し、予備乾燥して樹脂分50% のプリプレグとした。

mmの銅箔張り積層板を得た。プリプレグの重ね方はプ リプレグの表面側が板の両表面になるように重ね、か

a

積層した。得られた積層板は、織布基材の交差部分が入 らないように300mm×300mmにカットした。

【0018】〈実施例2〉ガラス織布基材として、

経糸 ECD450 1/0 ガラス糸 緯糸 ECD450 1/0 ガラス糸

経糸打込み本数 53本/25mm

緯糸打込み本数 53本/25mm

質量 48g/m² 厚み 0.05mm

経糸と緯糸の非交差部分の長さ

たて方向 350mm よこ方向 350mm

耳部の織り組織は平織りで耳幅は5mm

の条件で製織されたガラス織物基材を用いた以外は実施例1と同様にして、樹脂分60%のプリプレグを得た。このプリプレグを2枚と厚さ 18μ mの銅箔を両面に積層し、厚さ0.1mmの銅箔張り積層板を得た。この積層板を300m×300mmの大きさに切断した。

【0019】〈実施例3〉ガラス織布基材として、

経糸 ECE225 1/0 ガラス糸

緯糸 ECE225 1/0 ガラス糸

経糸打込み本数59本/25mm線糸打込み本数59本/25mm

 緯糸打込み本数
 59本/25mm

 質量
 105g/m2

経糸と緯糸の非交差部分の長さ

厘み

たて方向 3 5 0 mm よこ方向 3 5 0 mm

耳部の織り組織は平織りで耳幅は5mm

目止め部分の織り組織は平織りで間隔と織り幅は

 たて方向間隔
 350mm

 よこ方向間隔
 350mm

 たて方向織り幅
 5mm

 よこ方向織り幅
 5mm

の条件で製織されたガラス織物基材を用いた以外は実施例1と同様にして、樹脂分50%のプリプレグを得た。 【0020】<比較例1>ガラス織布基材として、WE

A116E [日東紡績(株)製]を用いた。

使用糸 ECE225 1/0 ガラス糸

経糸打込み本数

60本/25mm

緯糸打込み本数

58本/25mm

0.1mm

質量

105g/m2

0. 1 mm

の条件により平織製織されたガラス織布基材を用いた以外は実施例1と同様にして、樹脂分50%のプリプレグを得た。このプリプレグ2枚を用い、厚さ 18μ mの銅箔を両面に重ね、厚さ0.2mmの銅箔張り積層板を得た。

【0021】<比較例2>ガラス織布基材として、WE A05E [日東紡績(株) 製]を用いた。

10 使用糸 ECD450 1/0 ガラス糸

経糸打込み本数6 0 本/2 5 mm緯糸打込み本数4 6 本/2 5 mm

質量 48g/m²厚み 0.05mm

の条件により平織製織されたガラス織布基材を用いた以外は実施例1と同様にして、樹脂分60%のプリプレグを得た。このプリプレグ2枚を用い、厚さ18μmの銅箔を両面に重ね、厚さ0.1mmの銅箔張り積層板を得た。

20 【0022】実施例1、2および比較例1、2で得られた銅箔張り積層板について寸法変化率と表面平滑性を測定した。測定結果を表1、表2に示す。また、実施例1 および実施例3で得られたプリプレグについて緯糸のたるみ値を測定した。測定結果を表3に示す。

<寸法変化率測定方法>銅箔張り積層板にエッチング処理を施して、それぞれの積層板の両面にある銅箔を取り除き、その後170℃で30分キュア後に寸法変化を測定した。尚、寸法変化率はもとの銅箔張り積層板を基準として算出し求めた。その結果を表1に示す。

30 <表面平滑性測定方法>銅箔張り積層板にエッチング処理を施して、それぞれの積層板の両面にある銅箔を取り除き、表面平滑性を測定した。その結果を表2に示す。側定器:Surftest-201[ミツトヨ(株) 製]

<プリプレグの緯糸たるみ値の測定方法>プリプレグを300mm×300mmにカットした後、たて糸方向に垂直な直線を引き、JIS1級指定のステンレス直定規を用い、緯糸の目曲がりの最大となる値を測定した。その結果を表3に示す。

0 [0023]

【表1】

寸法変化率測定結果

	寸法変化率(%)		
	たて方向	よこ方向	
実施例 1 比較例 1 実施例 2 比較例 2	-0.005 -0.021 -0.007 -0.018	-0.005 -0.032 -0.006 -0.038	

[0024]

【表2】

表面平滑性測定結果

·	表面罕滑性(最大μm/1cm)			
	たて方向	よこ方向	ななめ方向	
実施例 1 比較例 1 実施例 2 比較例 2	1. 2 2. 2 0. 9 1. 5	1. 3 3. 0 1. 1 2. 0	1. 7 3. 4 1. 2 2. 5	

[0025] 【表3】

プリプレグの緯糸目曲り測定結果

	緯糸の最大目曲り(mm)
実施例 1	9
実施例2	2
i	

【0026】 表1、表2から明らかなように、実施例 1及び実施例2で得られた各ガラス繊維繊維強化エポキ 40 示す平面図 シ樹脂積層板においては、比較例1及び比較例2で得ら れたガラス繊維強化エポキシ樹脂積層板よりも寸法安定 性及び表面平滑性に優れ、又、寸法安定性については、 たて方向よこ方向に異方性がないことが分かる。また、 表3から明らかなように、実施例3で得られたプリプレ グにおいては、実施例1で得られたプリプレグよりも、 緯糸のたるみが小さく、見た目の良いプリプレグを提供

【0027】以上説明したように、本発明のガラス織布 基材を用いた積層板は、寸法安定性及び表面平滑性に優 50

れていることから、本発明のガラス織布基材を用いるこ とにより、IC等を自動挿入する実装方式に対応できる 30 プリント配線基板を可能にする。また、本発明のプリン ト配線基板は、製造方法や製造設備を従来の方法、設備 を用い、外観の良好なプリプレグを作成することができ るため、新たな設備投資を必要とせずに、UD材を強化 材とする積層板と同等な積層板を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のガラス織布基材の1例を示す平面図 【図2】 本発明のガラス織布基材の他の例を示す平面

【図3】 本発明のガラス織布基材のたるみの改良例を

【図4】 従来のガラス織布基材の拡大平面図

【図5】 プリプレグの緯糸たるみの測定方法概略図 【符号の説明】

1, 11, 111

本発明のガラス織布

基材

2, 22, 222, 6, 12

緯糸

3, 33, 333, 7

経糸

4,44

耳組織部

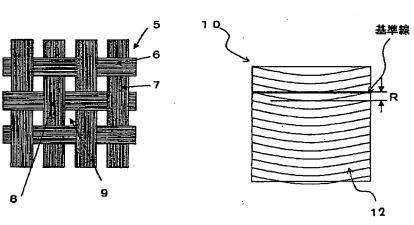
444

目止め用織り組織

従来のガラス織布基材

(8)

特開平11-241251



フロントページの続き

 (51) Int. Cl.*
 識別記号
 F I

 D 0 3 D
 15/12
 D 0 3 D
 15/12
 A

 25/00
 1 0 1
 25/00
 1 0 1